



广东汇能硅胶制品有限公司
GUANG DONG HUINGNG SILICONE CO, LTD

一、产品型号 (product model)

- ◆ 双组份导热凝胶 HN-NJ200

二、产品特征 (Product features)

- ◆ 高导热性: $2.0 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ 导热填料体系
- ◆ 双组份 1:1 混合: 操作简便, 混合粘度中
- ◆ 低应力: 凝胶态固化, 保护脆弱元器件。
- ◆ 电气绝缘
- ◆ 耐候性: -40°C 至 $+200^{\circ}\text{C}$ 长期稳定, 无油离或开裂。

三、性能用途 (Performance use)

- ◆ 电子芯片导热
- ◆ 新能源电源模组导热填缝剂
- ◆ 储能电池散热
- ◆ 汽车电子 OBC、DC-DC、域控制器导热
- ◆ 通讯设备单板、大型存储设备

四、技术参数 (Technical Data)

混合前		
	A	B
外观	白色膏体	浅灰色膏体
基料化学成份	聚硅氧烷	聚硅氧烷
黏度 (cP) (GB/2794-1995)	30000-40000mpa's	30000-40000mpa's
密度 (g/cm^3) (GB/2794-1995)	2.5 ± 0.02	2.5 ± 0.02
A+B 混合后		
外观	浅灰色膏体	
基料化学成份	聚硅氧烷	



黏度 (cP) (GB/2794-1995)	30000-40000mpa' s
密度 (g/cm ³) (GB/2794-1995)	2.5±0.02
操作时间 (25℃, min)	10-20
固化时间 (25℃, h)	2-4
硬度 (shore 00) (GB/T531-1999)	15-25
导热系数 (W/M•K) (GB/T 38712-2020)	2.0±0.1
介电强度 (kv/mm)	≥6

五、使用说明 (Direction for use)

- ◆ 混合: A:B=1:1 (重量比), 建议使用自动点胶设备 (静态混合管+双组份点胶机)。手工搅拌需确保无条纹 (混合时间≤3 分钟)。
- ◆ 脱泡: 真空脱泡 (-98kPa, 3-5 分钟) 避免微孔。
- ◆ 施工: 点胶/印刷厚度建议 0.2-2.0mm (依热设计需求)。
- ◆ 固化: 快速固化: 80℃×30 分钟 → 再 25℃×24 小时达到最终性能。

六、包装规格 (Packaging model)

- ◆ 包装规格: A/B 组分: 10kg/桶 (工业装)
- ◆ 定制包装: 400ml/支 (双组份卡筒)

七、技术服务 (Technology service)

- ◆ 提供完整的产品技术资料;
- ◆ 根据客户要求对产品的配方进行调试, 满足客户在产品某些特殊性能的要求;
- ◆ 本公司欢迎用户与我们的工程师合作, 沟通, 共同探讨解决方案。

八、储存

- ◆ 本品为无毒非危险品, 避免雨淋和曝晒, 储存于阴凉干燥处, 保质期 6 个月

使用者注意: 本文所刊载的都是我们认为可靠的资料, 由于实际情况千差万别, 我们不可能对所有情况一概了解, 所以不能保证我们的产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用产品之前应先自行测试产品, 然后再决定最佳的使用方法。